

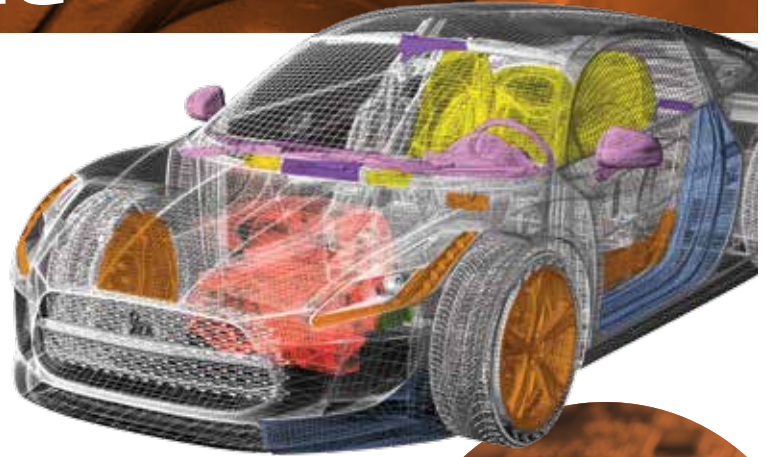
SOLDER PRODUCTS FOR AUTOMOTIVE MANUFACTURING

AVOID THE VOID[®]

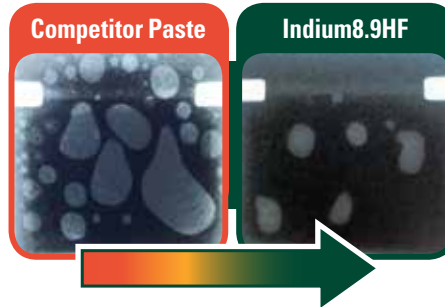
- +Response-to-pause printing performance
- +Stability

Halogen-Free, No-Clean Indium8.9HF Solder Paste Series

- Very low QFN & BGA voiding
- Industry leading performance across all key solder paste properties
- Best-in-class printing performance
- Unique oxidation barrier eliminates head-in-pillow and graping
- Room temperature stable



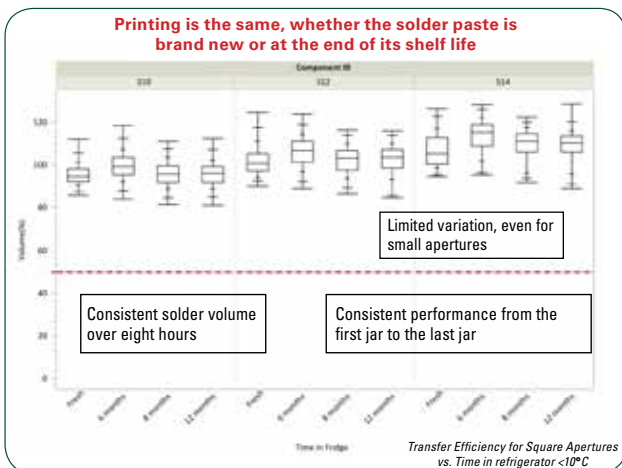
Halogen-Free, No-Clean



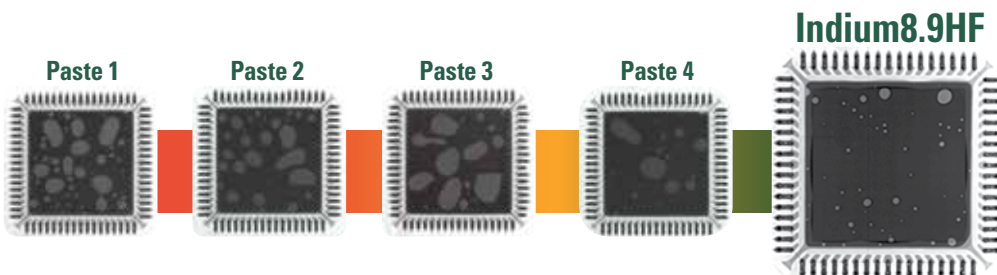
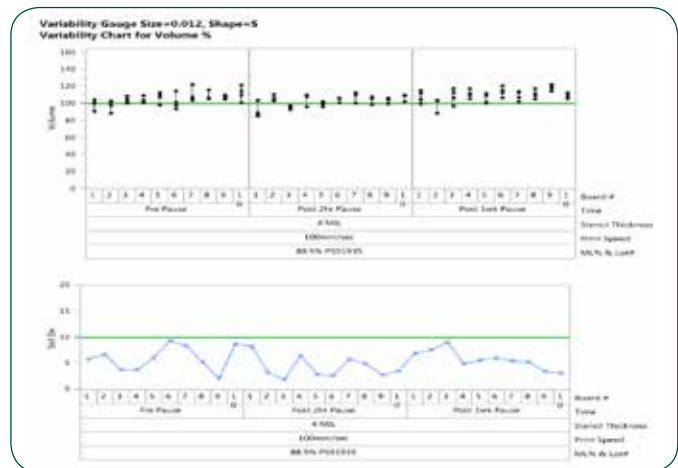
CUSTOMER EXPERIENCE:

From >40% voiding down to <11.6% by switching to Indium8.9HF

Room Temperature Stable



Excellent Response-to-Pause Print Performance



Contact our expert today: cnash@indium.com

Learn more: www.indium.com/avoidthevoid

From One Engineer To Another[®]

©2017 Indium Corporation

Form No. 99386 (A4) R0



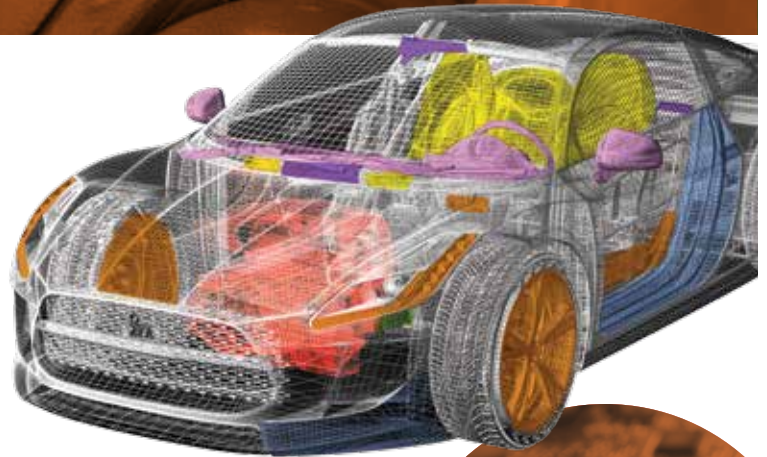
LOTMATERIALIEN FÜR DIE AUTOMOBIL- ELEKTRONIK

AVOID~~THE~~VOID®

+Ausgezeichnete Druckergebnisse
auch nach Unterbrechungen
+Stabilität

Halogenfrei und No-Clean Indium8.9HF Lotpasten-Serie

- Sehr niedriges Voiding bei QFN & BGA
- Führende Lotpasten-Eigenschaften bei allen Leistungsmerkmalen der Industrie
- Druckeigenschaften sind Best-in-Class
- Einzigartige Oxidationsbarriere verhindert Head-in-Pillow sowie Graping-Effekt
- Hohe Stabilität bei Raumtemperatur



Halogenfrei und No-Clean

Mitbewerber-Paste

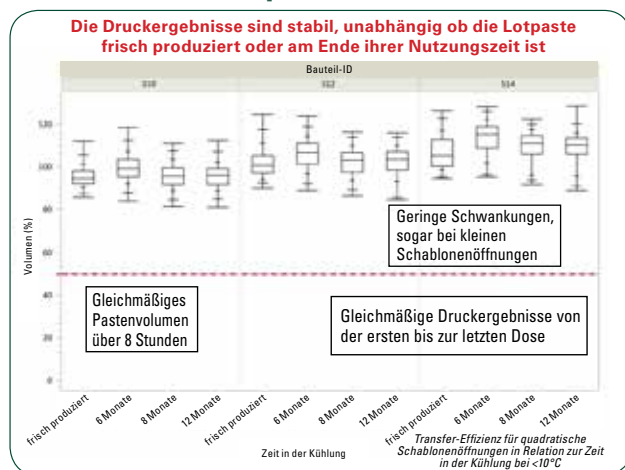
Indium8.9HF



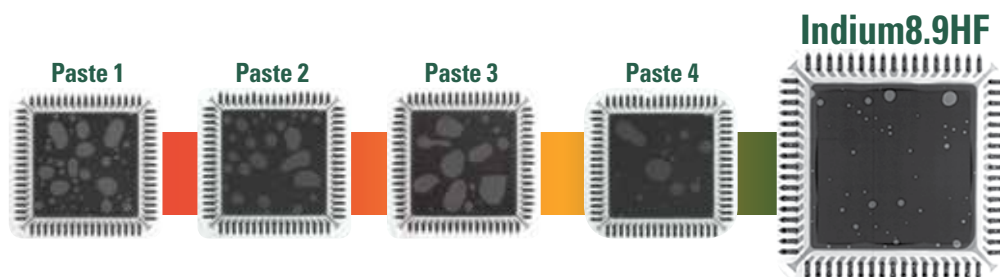
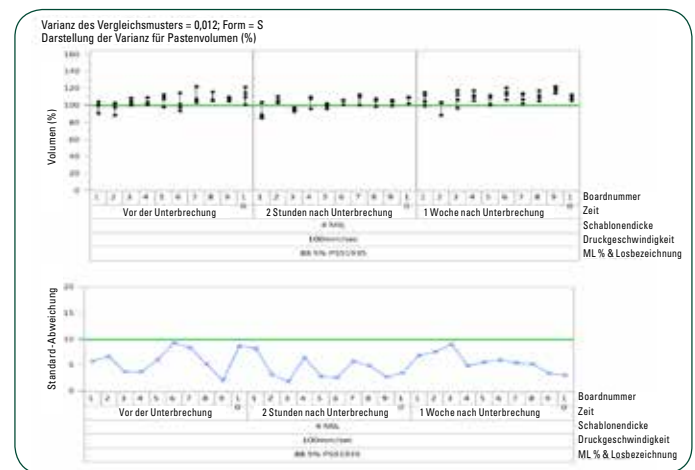
ANWENDER- ERFAHRUNG:

Von >40 % Voiding
erhebliche Minimierung
auf nur noch <11.6% mit
Indium8.9HF

Konstante Raumtemperatur



Ausgezeichnete Druckergebnisse auch nach Unterbrechungen



Sprechen Sie noch heute mit unserem Experten: akarch@indium.com

Hier erfahren Sie mehr: www.indium.com/avoidthevoid

From One Engineer To Another®

©2017 Indium Corporation

Formular No. 99386 (A4) R0

